

# 平成 15年 3月期 決算短信 (連結)

平成 15年 5月 20日

上場会社名 株式会社東京精密

上場取引所 東

コード番号 7729

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.accretech.jp/>)

代表者 代表取締役会長C.E.O. 大坪 英夫

問合せ先責任者 取締役業務会社執行役員社長 太田 邦正

TEL (0422) 48 - 1011

決算取締役会開催日 平成 15年 5月 20日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 15年 3月期の連結業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

(1)連結経営成績 (金額:百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 3月期	47,171	38.5	1,860	-	1,259	-
14年 3月期	34,064	△ 53.4	△ 1,757	-	△ 1,336	-

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	円 銭	%	%	%
15年 3月期	74	-	1 64	1 64	1 64	0.2	1.5	2.7
14年 3月期	△ 2,026	-	△ 54 21	-	-	△ 5.5	△ 1.6	△ 3.9

(注)①持分法投資損益 15年 3月期 - 百万円 14年 3月期 - 百万円

②期中平均株式数(連結) 15年 3月期 37,364,354 株 14年 3月期 37,373,761 株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

## (2)連結財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
15年 3月期	88,669	33,645	37.9	900 32
14年 3月期	79,865	35,423	44.4	947 90

(注)期末発行済株式数(連結) 15年 3月期 37,355,873 株 14年 3月期 37,370,643 株

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
15年 3月期	3,193	△ 4,312	1,248	6,193
14年 3月期	△ 9,568	△ 4,977	13,574	5,897

## (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 0 社

## (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1 社(除外) 0 社 持分法(新規) 0 社(除外) 0 社

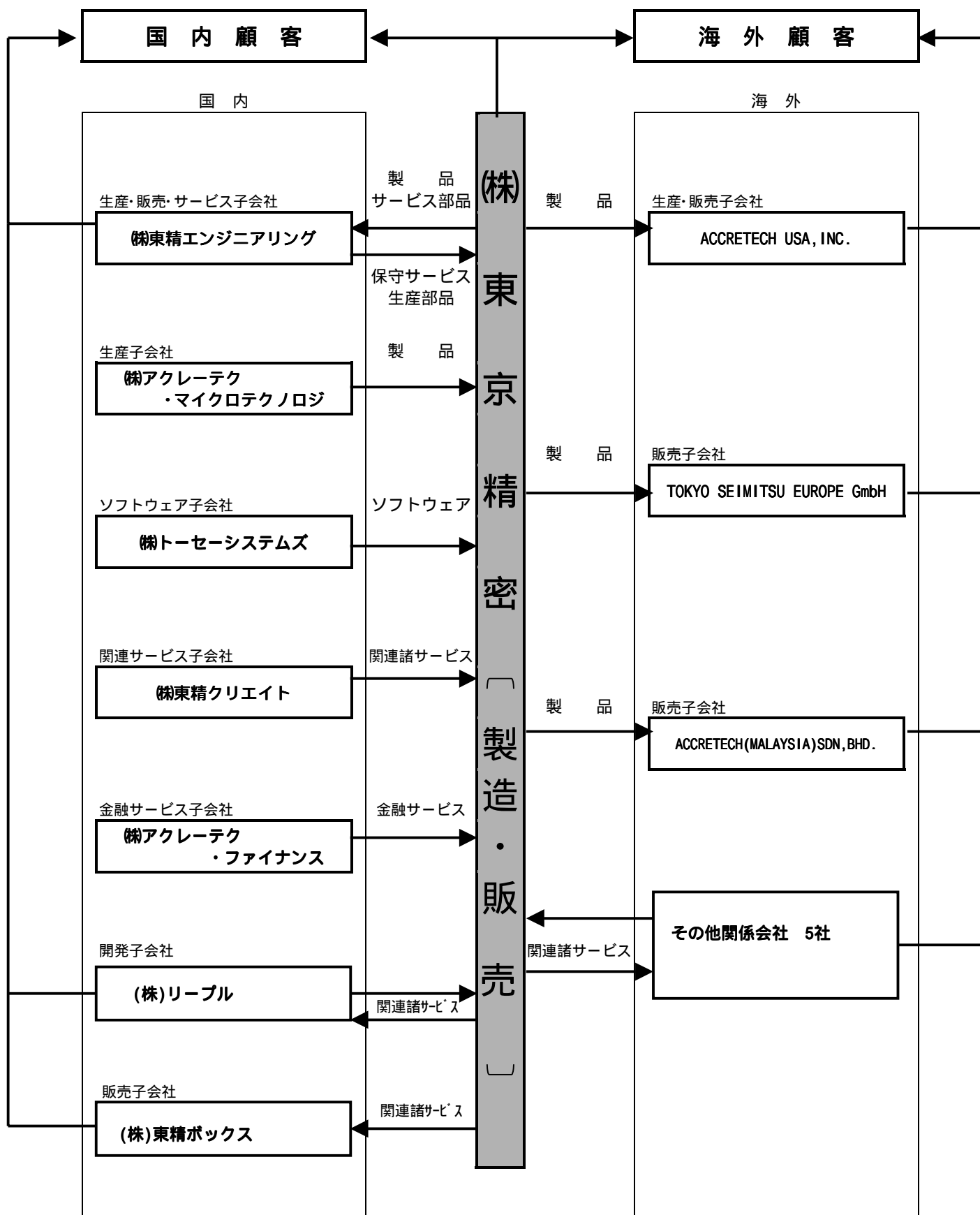
## 2. 16年 3月期の連結業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	28,000	1,100	200
通期	60,000	4,100	2,000

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 53 円 54 銭

※上記の予想は、7.8頁に記載した事項等を前提としています。

# 1 . 企業集団の状況



## 2 . 経営方針

### (1) 基本方針

当社は、精密計測機器及び半導体製造用機器メーカーとして、常にお客様の高生産性に寄与する最先端技術を駆使した製品開発とカスタマーサポートに注力してまいりました。技術革新が高レベルかつ高スピードで進行する環境下、当社が発展し続けるために最も重要な事は、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。そこで、以下に掲げる「製品開発の原則」を当社の経営の大原則として、市場の設備投資動向の影響を最小限に抑えつつ、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めております。

#### 「製品開発の原則」

世界 No.1 の製品を創る

マーケットシェア No.1 の商品は、

(a) 好況時の利益の極大化がはかれる

(b) 不況時の損失の極小化がはかれる

研究開発投資は自己資金で

技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う

相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する

また、「WIN - WIN の仕事で世界 No.1 の商品を創ろう」を当社の行動指針として制定し、「製品開発の原則」遵守を徹底して推進しております。世界 No.1 の製品開発には、各分野における最先端の技術とスピードが要求されます。そのためには、当社の培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、国内外の垣根を越えて、世界 No.1 の製品創りという共通目的をもつ会社および個人と“WIN - WIN”の協力関係を築くことが不可欠です。各国、各社のもつ異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな社風を醸成することにより、世界 No.1 の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しております。

当社のコーポレートブランド「ACCRETECH (アクレーテック)」は、「ACCRETE (= Grow Together の意味) + TECHNOLOGY」の合成語で、世界中の優れた技術・知恵・情報を融合して世界 No.1 の商品を創り、皆様とともに大きく成長いくという当社の企業理念を一語で表わしたものです。

### (2) ユニークな開発体制

当社は、1988 年より各技術開発グループを製品群別に分け、グループリーダーをヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任をもち、事業計画作成、設備投資及び人材の採用など大きな権限を与えられています。

2002 年 4 月、当社の執行役員制導入に伴い、グループリーダーは、執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制の備えている、開発計画などのスピーディな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

### (3) 利益配分に関する基本方針

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界 No.1 商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様へ利益還元を図りたいと考えております。配当につきましては、将来の事業展開のための企業体質強化に配慮の上、株主の皆様の長期的視点を重視した安定的な配当を実施してまいりたいと考えております。

内部留保金につきましては、当社が成長していくために不可欠な研究開発投資、生産設備投資などに有効に活用してまいりたいと存じます。

#### (4) 目標とする経営指標

当社は、株主の皆様が当社株式を所有する目的に沿った経営を行っております。従って、一株当たり利益の長期的な上昇とその結果としての企業価値の長期的な上昇を、経営上の重要な指標と考えています。

#### (5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は、前記の基本方針・開発体制に基づき、「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP装置」および「LEEPL転写装置」など、技術参入障壁が高く競争が少なく、マーケットも大きい、高機能・高価格の新製品を開発してきました。これらの新製品群は、いずれも当社従来製品に比べると、価格が十倍から数十倍も高い製品であります。

「ウェーハ外観検査装置」・「ポリッシュ・グライнда」・「CMP装置」は、2002年度に各ユーザーより高い評価を得て順調に売上が伸長しましたし、2003年度は一層の売上増加が見込まれます。また、次世代リソグラフィとして脚光をあびている「LEEPL転写装置」も2003年度に売上計上となる予定です。

このように、当社は、短・中期的には、新製品群が売上と利益の増大に本格的に寄与してくることにより、業界水準を上回る業容の拡大を果たし、順調に成長していくことができると予想しております。

さらに、より長期（10年以上）のことを考えますと、当社の従来製品（マシンコントロールゲージ、粗さ測定機、真円度測定機、三次元座標測定機、プロービングマシン、ダイシングマシンなど）が、将来、中国製品と競争する厳しい状況におかれることも想定しておく必要があります。当社は、高機能・高価格で競争の少ない新製品群の開発は、長期的な対中国シフトの観点からも重要と考え推進しているものであります。

#### (6) 会社の対処すべき課題

##### 新製品事業の成功

当社は、ここ数年来、上記新製品群の開発を積極的に進めてきて、着実に軌道に乗りつつありますが、今後とも各新製品について、計画通りに開発・生産・販売・サービスを推進し、事業を成功させ、業績の進展に貢献させることが肝要であります。

##### 財務構成の改善

当社は、2001年のシリコンサイクルの落ち込みによるプローバの在庫増と新製品関連資産の増加などにより、財務諸比率（自己資本比率など）が低下してまいりましたが、プローバの在庫増は2002年度で解消しましたし、新製品につきましても、2002年度より上昇した資産回転率が2003年度はさらに良くなることから、2003年度以降、財務諸比率は良化していく見込みです。

新製品群の販売が拡大している成長期の当社の場合、今後1~2期は、財務諸比率が緩やかな改善にとどまることを甘受しなければなりません。数年後には新製品群のフリーキャッシュフローが大きくプラスとなり、財務諸比率の早期改善が可能となる見通しです。

#### (7) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

##### <コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方>

企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、持続的な成長と発展を実現するには、その変化のスピードに対応できる経営体制の構築と、経営の国際標準化および株主重視経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しております。

## <コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況>

### 執行役員制とカンパニー制の導入

当社は、2002年4月に執行役員制と社内カンパニー制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3社で行うこととし、head office としての機能は廃止いたしました。

半導体社と計測社は、完結した組織として、夫々のお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるようになり、業務会社は、間接部門の合理化を推進しております。

また、2003年4月にトップマネジメントを改正し、会長 C.E.O.と社長 C.O.O.を分離いたしました。会長 C.E.O.は中長期の経営戦略に係わるものに専念し、日常の業務は各カンパニーの社長に委譲され、社長 C.O.O.が全社的な業務執行責任を負うこととなり、経営執行体制がより明確になりました。

### コーポレートガバナンスの実効性確保

A．社内カンパニー制の導入に伴い、株式会社東京精密は、理論的には取締役会のみになります。取締役会は、会社の重要な業務執行について決定したり、取締役の職務執行を監督する機関ですが、当社の取締役は出身企業が多岐にわたり、様々な会社で経験を重ねた人が取締役会を構成しており、当社の取締役会はハイブリッドな組織となっております。

B．当社の監査役は、当社の大株主出身の経営者で構成されており、4名のうち2名が社外監査役であります。当社監査役は、報酬委員会および経営諮問委員会のメンバーを兼務し、役員の報酬その他、経営の妥当性の判断も行っています。

C．以上のように当社の取締役会および監査役会のシステムは、日本、米国、ドイツのコーポレートガバナンスの長所をミックスした制度になっています。従って、当社のコーポレートガバナンスは、極めて透明性が高く、accountability が明確であります。

## 3. 経営成績及び財政状態

### (1) 経営成績

#### ① 当期の概況

##### [業績全般]

当期の世界経済につきましては、アジア地域が比較的堅調でありましたが、欧米では成長が減速し、日本経済もデフレ傾向が続くなど、全般景況は停滞感が強まりました。

半導体業界では、IT投資が伸び悩み通信機器やパソコン需要が低迷する反面、デジタル家電・DVD・デジタルカメラなどのデジタル・コンシューマ機器やカメラ付携帯電話の需要が好調に推移しました。国内外の半導体メーカーの設備投資は、総じて慎重でありましたが、好調部門や次世代・最先端分野では積極姿勢もみられました。

当社は、このような状況下、受注・売上の増強とコストダウンに努めました結果、半導体既存製品、半導体新製品とも前期比増収となり、利益面でも前期比改善となりました。

計測機器部門につきましては、日本経済の景気低迷の影響で、国内各ユーザーの設備投資は低調でありましたが、アジア・アメリカ等海外の需要が強く、海外売上の増加により前期比増収・増益となりました。

この結果、当期の連結売上高は 471 億 71 百万円（前期比 38.5%増）、連結経常利益は 12 億 59 百万円、連結当期利益 74 百万円となりました。

#### [各部門の概況]

##### A. 半導体製造用機器部門

- (a) 当社は、国内外の半導体メーカーの設備投資動向を的確に捉え、ニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、今期の売上高は 335 億 61 百万円（前期比 62.9%増）を達成いたしました。

利益面では、固定費削減、変動比率の引き下げなどの強力なコストダウン施策を推進しましたが、2001 年度の操業度低下による原価高在庫の要因などで粗利益率が低下し、10 億 22 百万円の営業損失を余儀なくされました。しかし、下期は上期比大幅に改善されており、次期は営業黒字を見込んでおります。

主力商品のウェーハプロ・ピングマシンでは、300mm ウェーハ対応の第三世代機となる最新鋭機種「UF3000」を開発し、販売を開始しました。システム LSI などの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まであらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プロ・ピングマシンで、お客様から CoO と OEE（設備総合効率）の両面で高い支持を得ており、着実に販売を伸ばしています。

ウェーハダイシングマシンにつきましても、300mm 対応の「A - WD - 300T」が生産性の高いマシンとして機能を高く評価され、売上が堅調に推移しております。

ウェーハ外観検査装置では、「WIN - WIN50 1200」を新しく発売し、高感度・高スループットのマシンとして評価が高まっており、売上が伸長しています。

ポリッシュ・グラインダ「PG200」・「PG300」も内外に顧客層を拡大しており、隣接工程をインテグレートとした RM タイプも需要が増えています。

また、CMP 装置「A - FP - 210A」につきましても、2002 年度下期に売上計上となり、次期は一層の販売増が期待されます。

- (b) 研究開発につきましても、300mm ウェーハへの移行や微細化が進展するなかで、300mm 対応機種をはじめ、市場ニーズに適合する次世代装置のタイムリーな開発に注力しております。

ダイシングマシンでは、浜松ホトニクス株式会社と業務提携し、同社が開発したステルスダイシング技術を使って、ウェーハ表面に損傷を与えず、洗浄不要、完全ブロードレスで、チップ分割を行う新型レーザダイシング装置「MAHOH Dicing Machine」の開発を進めています。

ウェーハ外観検査装置では、当社と株式会社日立ハイテクノロジーズが共同開発した 90nm ノード以降に対応できる「HA - 3000 ウェーハ外観検査装置」を発表し、市場投入しました。

子会社の株式会社リープルが進めている 100nm ~ 35nm の微細回路製造用転写装置「LEEPL 転写装置」の開発は順調に進んでおり、次期に量産 1 号機の販売を目指しています。

また、2001 年 6 月、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の 3 社が、次世代リソグラフィ技術の開発促進と普及を目的に、各業界に呼びかけて、「LEEPL 技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカーの 13 社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では 29 社が活動しています。

「LEEPL 転写装置」は、次世代リソグラフィの本命として脚光を浴びておりますが、今後、コンソーシアム活動を通じて、リープル技術と周辺技術の開発が一層加速され、リープル事業が当社のコア事業に成長していくものと予想しております。

また、当社は、LEEPL 技術の開発・促進に必要な「電子ビームマスク用欠陥検査装置」につきましても、開発に着手しており、計画どおり順調に進捗しています。

## B．計測機器部門

- (a) 計測機器部門につきましては、ユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、国内の落込みを抑え、需要の強い海外売上を伸ばした結果、売上高は 136 億 10 百万円（前期比 1.1%増）となりました。

生産面でもコストダウンに注力し、営業利益も 28 億 82 百万円（前期比 39.0%増）と増益を達成しました。

汎用計測機器では、世界最高精度を誇る表面粗さ形状測定機「サーフコム 3000A」や高精度で好評の真円度測定機「ロンコムシリーズ」の売上が堅調に推移しました。また、カールツァイス社と提携し、高品質に定評のある三次元座標測定機の売上が前期比伸長しています。自動計測機器では、「パルコムシリーズ」が流体軸受向けなどに好調でありました。

- (b) 研究開発につきましては、駆動部に初めてリニアモータを採用し、世界最高レベルの測定スピードと低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム 1500DX」と、同じくリニアモータ採用で、高い測定精度を実現した輪郭形状測定機「コンターレコード 1700DX」を開発し、2003 年 4 月より販売開始いたしました。

また、当社の高剛性設計技術とカールツァイス社の解析・制御技術を融合して、新しく開発した CNC 三次元座標測定機の新シリーズ「ザイザックス SVA」も 2003 年 4 月より販売を開始しています。

### [自動計測部門の営業譲渡]

当社は、2002 年 12 月 31 日に自動計測機器部門を、連結子会社である株式会社東精エンジニアリングに譲渡いたしました。譲渡価額は 36 億 74 百万円、譲渡益は 29 億 36 百万円であります。

### [利益配分について]

当期の配当に関しましては、中間配当として 1 株当たり 15 円を実施いたしました。期末配当につきましては、厳しい状況下ではありますが、前述の利益配分の基本方針と下記理由から 15 円を継続し、一株当り年間配当で 30 円とすることを第 80 期定時株主総会で提案させていただく予定であります。

- A．半導体産業は、市況の急伸・急落があるので短期の業績を直ちに配当に反映させることは、長期的視点で保有していただいている株主の皆様の視点と合致しないこと。  
B．当社の財務状況と今後のキャッシュフロー、及び平成 15 年 3 月末未処分利益 91 億 76 百万円から、一株当り 30 円配当継続には無理のないこと。

## ② 次期の見通し

### [業績全般及び各部門の概況]

#### A．半導体製造用機器部門

2003 年度の半導体市場は、IT 投資の回復と DVD をはじめとするデジタル機器の需要増加などにより、年度後半から次世代・最先端ラインを中心に、設備投資の回復が期待されます。しかし、一方で世界的な株価低迷や SARS の経済への影響などの不安定要因から、企業の在庫積み増しや設備投資への慎重姿勢が続くことも考えられ、先行き不透明感がぬぐえない状況にあります。

このような状況下、当社は、2003年度の半導体製造用機器部門の市場動向をゆるやかな回復にとどまるものと考え、マーケットシェアの高いウェーハプロ・ビングマシンやウェーハダイシングマシンなどの既存製品の売上高を7%程度の増加と予定しております。

一方、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ、CMP装置の新製品群は、各ユーザーの評価が着実に高まっていることから、引合い・受注動向などより考えて、引続きマーケットシェアを伸ばし、売上高も前期比倍増以上を計画しております。

以上より、半導体製造用機器部門の2003年度の売上高は、450億円（前期比34.1%増）を予想しております。

## B. 計測機器部門

計測機器部門につきましては、国内における全般景況の回復は緩やかであるものの、自動車関連の各ユーザーなどでは、前向きな設備投資姿勢もみられます。また海外は、アジア地域を中心に堅調な需要が見込まれますが、SARSの影響が懸念されます。

かかる状況下、お客様のニーズを的確に把握し受注に繋げるとともに、4月より発売した高性能の新製品群も積極的に拡販し、2003年度売上高は、150億円（前期比10.2%増）を予定しています。

以上のような予測の下、2003年度の連結売上高600億円（前期比27.2%増）、連結経常利益41億円（同225.5%増）、連結当期純利益20億円と予想しております。

### [利益配分について]

上記業績見通し及び前述の利益配分に関する基本方針に従い、次期配当金につきましては、安定的な配当を継続することとし、年間配当で1株当たり30円（うち中間配当金15円）を予定しております。

## (2) 財政状態

当期末における現金及び現金同等物は、前期末より3億円増加し、61億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは31億円の増加となりました。これは主に売上債権の増加（41億円）、減価償却費（25億円）、および支払債務の増加（62億円）などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは43億円の減少となりました。これは当社および連結子会社による設備投資支出（37億円）などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、12億円の増加となりました。これは主に、社債の発行（20億円）、長期借入金の実行（50億円）、短期借入金の返済（33億円）、長期借入金の返済（12億円）および配当金（11億円）などによるものであります。

当期の営業キャッシュ・フローは、前期に比べ大幅に改善されていますが、次期は新製品の売上拡大や利益計上などにより、さらに営業キャッシュ・フローの好転が見込まれ、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込です。

### 将来の事象に係る記述に関する注意

この決算短信に記載されている業績見通しに関する記載内容につきましては、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。

これらは、市況、競争状況、ならびに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

#### 4 . 比較連結貸借対照表

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	前 期 (平成 14 年 3月 31 日現在)	当 期 (平成 15 年 3月 31 日現在)	科 目	前 期 (平成 14 年 3月 31 日現在)	当 期 (平成 15 年 3月 31 日現在)
資 産 の 部			負 債 の 部		
流動資産	53,234	59,062	流動負債	31,227	38,964
現金及び預金	5,924	6,220	支払手形及び買掛金	5,242	11,245
受取手形及び売掛金	12,156	16,180	短期借入金	22,815	19,486
たな卸資産	34,127	34,075	一年以内返済予定		
未収消費税等	104	364	長期借入金	264	3,297
繰延税金資産	298	904	一年以内償還予定		
その他流動資産	658	1,356	社債	-	200
貸倒引当金	36	40	未払法人税等	296	598
			賞与引当金	608	584
			その他流動負債	2,001	3,552
固定資産	26,630	29,606	固定負債	11,448	14,162
(有形固定資産)	(13,849)	(15,578)	社債	250	2,050
建物及び構築物	6,041	5,762	転換社債	51	51
機械装置及び運搬具	3,223	3,868	長期借入金	7,765	8,446
工具器具備品	823	742	退職給付引当金	2,794	3,107
土地	2,916	2,919	役員退職慰労引当金	540	461
建設仮勘定	843	2,287	繰延税金負債	47	45
(無形固定資産)	(6,358)	(7,580)	負債合計	42,676	53,126
ソフトウェア	6,200	6,845			
その他無形固定資産	158	735	少数株主持分	1,764	1,897
(投資その他の資産)	(6,423)	(6,447)			
投資有価証券	2,853	2,407	資 本 の 部		
長期貸付金	100	56	資本金	7,199	7,199
繰延税金資産	2,858	3,426	資本準備金	11,806	
その他の投資			連結剰余金	16,463	
その他の資産	702	606	資本剰余金		11,806
貸倒引当金	91	49	利益剰余金		15,191
繰延資産	0	0	その他有価証券評価差額金	244	617
社債発行差金	0	0	為替換算調整勘定	208	111
			自己株式	10	46
			資本合計	35,423	33,645
資産合計	79,865	88,669	負債、少数株主持分 及び資本合計	79,865	88,669

## 5 . 比較連結損益計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前 期		当 期	
		自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日
売 上 高		34,064		47,171	
売 上 原 価		24,460		35,828	
売 上 総 利 益		9,604		11,343	
販売費及び一般管理費		( 11,362 )		( 9,482 )	
販 売 費		7,856		7,229	
一 般 管 理 費		3,505		2,253	
営業利益または営業損失 ( )		1,757		1,860	
営業外収益		( 772 )		( 297 )	
受 取 利 息		25		7	
受 取 配 当 金		98		136	
為 替 差 益		337		-	
そ の 他		311		153	
営業外費用		( 351 )		( 897 )	
支 払 利 息		218		279	
為 替 差 損		-		500	
そ の 他		132		118	
経常利益または経常損失 ( )		1,336		1,259	
特 別 利 益		( 1,904 )		( 123 )	
連結子会社株式売却益		1,902		-	
土 地 売 却 益		-		123	
そ の 他		2		-	
特 別 損 失		( 2,667 )		( 1,307 )	
たな卸資産評価損及び廃却損		1,779		903	
投資有価証券評価損		612		22	
そ の 他		275		381	
税金等調整前当期純利益または 税金等調整前当期純損失 ( )		2,099		75	
法人税、住民税及び事業税		600		694	
法人税等調整額		821		908	
少数株主利益		147		215	
当期純利益または当期純損失 ( )		2,026		74	

## 6 . 比較連結剰余金計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	前 期		当 期	
	自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日		自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日	
<b>I 連結剰余金期首残高</b>		20,401		
<b>II 連結剰余金減少高</b>				
1. 配当金	1,121			
2. 取締役賞与金	64			
3. 自己株式消却額	726	1,912		
<b>III 当期純損失</b>		△ 2,026		
<b>IV 連結剰余金期末残高</b>		16,463		
(資本剰余金の部)				
<b>I 資本剰余金期首残高</b>				
資本準備金期首残高			11,806	11,806
<b>II 資本剰余金増加高</b>			—	—
<b>III 資本剰余金減少高</b>			—	—
<b>IV 資本剰余金期末残高</b>				11,806
(利益剰余金の部)				
<b>I 利益剰余金期首残高</b>				
連結剰余金期首残高			16,463	16,463
<b>II 利益剰余金増加高</b>				
1. 当期純利益			74	74
<b>III 利益剰余金減少高</b>				
1. 配当金			1,121	
2. 取締役賞与金			12	
3. 連結子会社増加による利益剰余金減少高			212	1,346
<b>IV 利益剰余金期末残高</b>				15,191

## フ . 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

科 目	期 別	前連結会計年度	当連結会計年度
		自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日	自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益(純損失)		2,099	75
減価償却費		1,860	2,579
連結調整勘定償却額		-	80
退職給付引当金の増減額		18	312
役員退職慰労引当金の増減額		293	79
貸倒引当金の増減額		3	40
受取利息及び受取配当金		124	143
支払利息		218	279
土地売却益		-	123
有形固定資産除却・売却損益		34	48
投資有価証券・ゴルフ会員権評価損		639	26
社債償還損		5	-
連結子会社株式売却益		1,902	-
新株式引受権戻入益		2	-
売上債権の増減額		15,389	4,142
たな卸資産の増加額		1,261	198
販売用ソフトウェアの減少額		172	-
仕入債務の増減額		16,486	6,283
取締役賞与の支払額		64	12
その他営業活動による支出		885	1,225
小計		4,226	3,719
利息及び配当金の受取額		124	143
利息の支払額		270	261
法人税等の支払額		5,195	408
営業活動によるキャッシュ・フロー計		9,568	3,193
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入		187	20
定期預金の払出		364	20
有価証券・投資有価証券の取得		604	703
関係会社出資		-	41
連結子会社株式の売却		1,861	-
有形固定資産の取得		5,971	3,203
無形固定資産の取得		521	497
有形固定資産の売却		7	89
貸付金の実行		9	-
貸付金の回収		82	43
投資活動によるキャッシュ・フロー計		4,977	4,312
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金増減額		11,695	3,309
長期借入金の実行		2,200	5,000
長期借入金の返済		272	1,284
連結子会社の増資		1,353	-
新株引受権の権利行使		369	-
社債の発行		190	2,000
社債の償還		105	-
自己株式の消却		726	-
配当金の支払額		1,121	1,121
その他財務活動による支出		10	35
財務活動によるキャッシュ・フロー計		13,574	1,248
現金及び現金同等物に係る換算差額		83	40
現金及び現金同等物の増減額		888	170
現金及び現金同等物の期首残高		6,785	5,897
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額		-	125
現金及び現金同等物の期末残高		5,897	6,193

## 8 . 連結財務諸表作成の基本となる事項

### 1 . 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社(8社)

(株)東精エンジニアリング、(株)トーセシステムズ、(株)アクレーテック・マイクロテクノロジー、(株)東精クリエイト、(株)アクレーテック・ファイナンス、(株)リーブル、ACCRETECH USA, INC.、TOKYO SEIMITSU EUROPE GmbH

#### (2) 非連結子会社(6社)

(株)東精ボックス、ACCRETECH(MALAYSIA)SDN,BHD.、ACCRETECH(ISRAEL)LTD.、ACCRETECH(SINGAPORE)PTE LTD.、ACCRETECH MICRO TECHNOLOGIES KOREA CO.,LTD、東精精密設備(上海)有限公司

連結の範囲から除いた理由は、上記6社いずれも小規模会社であり、合計の総資産・売上高・当期純損益及び利益剰余金等の金額がいずれも僅少であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないためであります。

### 2 . 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社6社及び関連会社三門峡中原精密有限責任公司については、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず原価法により評価しております。

### 3 . 連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

### 4 . 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### (イ) 有価証券

##### a 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### b その他の有価証券

時価のあるもの……連結会計期間末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法による原価法により算定しています。)

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

##### (ロ) たな卸資産

親会社及び国内連結子会社は、商品・製品・材料及び貯蔵品については、先入先出法による原価法、仕掛品については、個別法による原価法であります。

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### (イ) 有形固定資産

親会社及び国内連結子会社は、定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物付属設備は除く)については、定額法によっております。

##### (ロ) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェアは、見込販売数量に基づく方法又は残存有効期間に基づく定額法によっており、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間に基づく定額法によっております。その他の無形固定資産は、定額法であります。

#### (3) 重要な引当金の計上基準

##### (イ) 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (ロ) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額基準により計上しております。

##### (ハ) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額をそれぞれ発生の日翌連結会計年度より費用処理しております。

(二) 役員退職慰労引当金

役員の退任時に支出が予想される役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく連結会計期間末支払見込額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(追加情報)

(1) 当期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。

これによる当期の損益に与える影響はありません。

(2) 当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。

これによる影響はありません。

## 9. セグメント情報

### (1) 事業の種類別セグメント情報

〔前期〕(平成13年4月1日～平成14年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消去 又は全社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	20,607	13,457	34,064	-	34,064
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	20,607	13,457	34,064	-	34,064
営業費用	24,438	11,383	35,822	-	35,822
営業利益	3,831	2,073	1,757	-	1,757
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	62,220	15,295	77,515	2,349	79,865
減 価 償 却 費	1,527	332	1,860	-	1,860
資 本 的 支 出	4,267	253	4,521	-	4,521

〔当期〕(平成14年4月1日～平成15年3月31日) (単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	半導体製造用 機器関連事業	計測機器 関連事業	計	消去 又は全社	連 結
.売上高及び営業損益					
外部顧客に対する売上高	33,561	13,610	47,171	-	47,171
セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-
計	33,561	13,610	47,171	-	47,171
営業費用	34,583	10,727	45,311	-	45,311
営業利益	1,022	2,882	1,860	-	1,860
.資産、減価償却費及び資本的支出					
資 産	71,091	14,290	85,381	3,287	88,669
減 価 償 却 費	2,255	323	2,579	-	2,579
資 本 的 支 出	2,029	303	2,333	-	2,333

(注) 1. 当社の事業区分は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性を考慮して行っております。

#### 2. 各事業区分の主要製品

##### (1) 半導体製造用機器関連事業

ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ(ウェーハ裏面研磨装置)  
ウェーハプロービングマシン、ウェーハダイシングマシン  
ウェーハマニファクチャリングマシン

##### (2) 計測機器関連事業

三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度・円柱形状測定機  
電気マイクロメータ、マシンコントロールゲージ、各種自動測定・選別・組立機

#### 3. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金(出資金及び投資有価証券)等であり、その金額は次のとおりであります。

〔前期〕 2,349百万円                      〔当期〕 3,287百万円

(2) 所在地別セグメント情報

〔前期〕(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	日本	米国	ドイツ	計	消却 又は全社	連結
・売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	25,633	6,015	2,416	34,064	-	34,064
セグメント間の内部売上高又は振替高	4,269	-	-	4,269	(4,269)	-
計	29,902	6,015	2,416	38,334	(4,269)	34,064
営業費用	30,685	6,763	2,624	40,073	(4,251)	35,822
営業利益	783	748	207	1,739	(18)	1,757
資産	74,938	5,912	1,579	82,430	(2,564)	79,865

〔当期〕(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	日本	米国	ドイツ	計	消却 又は全社	連結
・売上高及び営業損益						
外部顧客に対する売上高	37,268	7,440	2,462	47,171	-	47,171
セグメント間の内部売上高又は振替高	5,910	-	-	5,910	(5,910)	-
計	43,179	7,440	2,462	53,082	(5,910)	47,171
営業費用	41,299	7,796	2,425	51,521	(6,209)	45,311
営業利益	1,880	355	37	1,561	298	1,860
資産	82,529	5,316	1,185	89,031	(361)	88,669

(注) 1. 国別の区分の方法

国別の区分の方法は、事業活動の地域的独立性に基づいて決定しております。

2. 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金、長期投資資金(投資有価証券)等であり、その金額は次のとおりです。

〔前期〕 2,349百万円

〔当期〕 3,287百万円

(3) 海外売上高

〔前期〕(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北米	欧州	その他	計
・海外売上高	4,713	5,526	2,708	920	13,869
・連結売上高					34,064
・連結売上高に占める 海外売上高	13.8%	16.2%	8.0%	2.7%	40.7%

〔当期〕(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	東アジア	北米	欧州	その他	計
・海外売上高	10,916	7,069	2,826	1,997	22,811
・連結売上高					47,171
・連結売上高に占める 海外売上高	23.2%	15.0%	6.0%	4.2%	48.4%

(注) 1. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

2. 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

東アジア.....韓国、台湾、中国                      北米.....米国、カナダ

欧州.....ドイツ、英国、イタリア                      その他.....シンガポール、マレーシア、フィリピン

## 10. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

事業の種類別 セグメントの名称	前 期		当 期	
	自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	前年同期比(%)	自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	前年同期比(%)
半導体製造用機器	20,331	68.8 %	32,965	+ 62.1 %
計 測 機 器	15,376	9.4 %	14,724	4.2 %
合 計	35,707	56.5 %	47,689	+ 33.6 %

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

### (2) 受注状況

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前 期		当 期	
	自平成13年4月1日 至平成14年3月31日		自平成14年4月1日 至平成15年3月31日	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
半導体製造用機器	13,051	5,533	35,240	7,212
計 測 機 器	12,216	1,810	14,007	2,207
合 計	25,268	7,344	49,248	9,420

(注) 金額表示は販売価格(消費税抜き)によっております。

### (3) 販売実績

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

区 分	前 期		当 期	
	平成13年4月1日 平成14年3月31日	前年同期比(%)	平成14年4月1日 平成15年4月31日	前年同期比(%)
半導体製造用機器	20,607	64.8 %	33,561	+ 62.9 %
計 測 機 器	13,457	8.1 %	13,610	+ 1.1 %
合 計	34,064	53.4 %	47,171	+ 38.5 %

(注) 金額表示は消費税抜きであります。

## 1 1 . 有価証券の時価等

〔前 期〕(平成 14 年 3 月 31 日現在)

( 1 ) 時価のある有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	取得原価	連結貸借対照表計上	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	176	238	61
そ の 他	40	40	0
小 計	216	279	62
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	2,136	1,651	484
そ の 他	-	-	-
小 計	2,136	1,651	484
合 計	2,353	1,931	422

( 2 ) 時価のない有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	922
そ の 他	-
合 計	922

〔当 期〕(平成 15 年 3 月 31 日現在)

( 1 ) 時価のある有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	取得原価	連結貸借対照表計上	差 額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株 式	80	93	13
そ の 他	40	40	0
小 計	120	134	14
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株 式	2,413	1,358	1,055
そ の 他	-	-	-
小 計	2,413	1,358	1,055
合 計	2,533	1,492	1,040

( 2 ) 時価のない有価証券

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

	連結貸借対照表計上額
非 上 場 株 式	914
そ の 他	-
合 計	914

## 1 2 . デリバティブ取引の状況

当 期 (自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 3 月 31 日)

該当事項はありません。

## 1 3 . 退職給付関係

### ( 1 ) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、総合設立の厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けています。国内連結子会社は、退職一時金制度と一部適格退職年金制度を採用しております。

### ( 2 ) 退職給付債務に関する事項 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

イ . 退 職 給 付 債 務	7,535
ロ . 年金資産(退職給付信託分を含む)	1,489
ハ . 退 職 給 付 引 当 金	3,107
<u>差引(イ - ロ - ハ)</u>	<u>2,938</u>
(差引分内訳)	
ニ . 未 認 識 数 理 差 異 の 未 処 理 額	2,938

### ( 3 ) 退職給付費用に関する事項 (平成 15 年 3 月 31 日現在)

(単位 百万円：百万円未満を切り捨てて表示)

イ . 勤 務 費 用	341
ロ . 利 息 費 用	178
ハ . 期 待 運 用 収 益	18
ニ . 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額	205
ホ . 会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 費 用 処 理 額	-
ヘ . 退 職 給 付 費 用 (イ + ロ - ハ + ニ + ホ)	706

### ( 4 ) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ . 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 配 分 方 法	期 間 定 額 基 準
ロ . 割 引 率	3.0 %
ハ . 期 待 運 用 収 益 率	2.5 %
ニ . 数 理 計 算 上 の 差 異 の 処 理 年 数	10 年

## 14. リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に関する注記

### (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	[前期]	[当期]
[機械装置]		
取得価額相当額	1,876	2,085
減価償却累計額相当額	102	412
期末残高相当額	1,773	1,672
[工具器具備品]		
取得価額相当額	577	730
減価償却累計額相当額	239	391
期末残高相当額	337	338

### (2) 未経過リース料期末残高相当額

	[前期]	[当期]
[機械装置]		
一年以内	255	295
一年超	1,531	1,422
合計	1,786	1,718
[工具器具備品]		
一年以内	125	184
一年超	218	161
合計	344	345

### (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

	[前期]	[当期]
[機械装置]		
支払リース料	118	357
減価償却費相当額	102	309
支払利息相当額	29	79
[工具器具備品]		
支払リース料	140	194
減価償却費相当額	132	186
支払利息相当額	9	8

### (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

## 15. 関連当事者との取引

該当事項はありません。